

**Deca 社と Silicon Storage Technology 社、
NVM チップレット ソリューションの実現に向けた戦略的提携を発表**

モジュール式のメモリ セントリックな基盤を提供し、
先進のマルチダイ アーキテクチャを実現

2025 年 9 月 11 日[NASDAQ: MCHP] - 従来のモノリシックなチップ設計では複雑さが増しコストが上昇するため、半導体業界ではチップレット技術への関心とその採用が高まりを見せています。Deca Technologies 社と、Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫛晴彦 以下 Microchip 社)の子会社である Silicon Storage Technology®(SST®、以下 SST 社)は本日、モジュール式マルチダイ システムの採用を促進するため、包括的な NVM(不揮発性メモリ)チップレット パッケージを実現させる戦略的契約を締結した事を発表しました。

この提携により、Deca 社の M-Series™ ファンアウト技術と Adaptive Patterning®技術が SST 社の業界最高レベルの SuperFlash®組み込みフラッシュ技術と組み合わせられます。両社はシステムレベル統合に関するそれぞれの専門知識を活かし、顧客による NVM チップレットの設計、検証、商用化を可能にするバンドル製品を提供します。アーキテクチャの柔軟性をさらに高めるこのソリューションは、従来のモノリシック集積と比べて技術面でも商用面でも優れています。

両社の強みが組み合わせられたこのソリューションは、先進のマルチダイ アーキテクチャに適した、モジュール式のメモリ セントリックな基盤を提供します。このチップレット パッケージは SST 社の SuperFlash 技術を活用したもので、自己完結型チップレットとして機能するために必要なインターフェイス ロジックと物理設計要素を備えています。また、Adaptive Patterning に基づく再配線層(RDL)設計ルール、シミュレーションフロー、テスト戦略、Deca 社の認定パートナーのエコシステムによる製造経路が用いられています。

Deca 社と SST 社はこの基盤に基づき、初期設計から認定およびプロトタイプ製造に至るまで共同で顧客をサポートします。両社は統合の効率化と設計サイクルの加速により、ヘテロジニアス集積の幅広い導入を実現し、世界中の顧客との連携を通じてチップレット ソリューションを市場に投入する事を目指しています。

Deca 社の戦略的エンゲージメントおよびアプリケーション担当 VP である Robin Davis 氏は次のように述べています。「チップレット集積は、性能、拡張性、開発期間に対する業界の見方を一新しつつあります。弊社と SST 社との提携により、お客様は様々なファウンダリによる各種チップ、プロセスノード、サイズ、ダイを組み合わせたチップレット ソリューションを開発し、より効率的で対費用効果の高い製品を提供できるようになります」

チップレット技術は、「More Than Moore (ムーアの法則を超える)」アプローチを実現する事で半導体設計および製造に多大な利点をもたらします。設計者は従来のスケーリングを超える方法で機能拡張と性能向上を実現し、より迅速に製品を市場に投入できます。チップレットでは既存 IP の再利用が可能で、先進プロセスノードと低コストのレガシー ジオメトリを組み合わせる事もできます。特定の機能に最も

Deca 社と Silicon Storage Technology 社、NVM チップレット ソリューションの実現に向けた戦略的提携を発表

2-2-2-2

適したダイ技術を利用できるチップレットは、先進の半導体イノベーションの実現に向けた、汎用性のある効率的で経済的な手段となります。

Microchip 社のライセンス ビジネス部門副社長の Mark Reiten は次のように述べています。「お客様がムーアの法則の限界を超えようとする中で、チップレット ベースのソリューションへの関心が高まっています。今回の提携の目的は、チップレットの開発と製造を成功させるために必要な IP、シミュレーションツール、先進アセンブリ、エンジニアリングサービスを含む包括的なパッケージを提供する事です」

価格と在庫/供給状況

SST 社の SuperFlash 技術の詳細は [SST 社のウェブサイト](#) をご覧ください。NVM チップレット ソリューションの詳細は [SST 社の各地域における販売担当者](#) にお問い合わせください。Deca 社の技術および製品の詳細は [Deca 社のウェブサイト](#) をご覧頂くか、[Deca 社のマーケティング窓口](#) にお問い合わせください。

リソース

高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickr でご覧ください。掲載に許可は不要です。

- アプリケーション画像: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/54745873597/sizes/o/

Microchip Technology 社について

Microchip Technology 社(以下、Microchip 社)はスマート、コネクテッド、セキュアな組み込み制御ソリューションおよび処理ソリューションのトッププロバイダです。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、リスクを低減する最適な設計を作成し、総システムコストの削減、迅速な商品化を実現できます。Microchip 社は産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で 100,000 社を超えるお客様にソリューションを提供しています。Microchip 社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、優れた技術サポート、確かな納期、高い品質を提供しています。詳細は Microchip 社ウェブサイト(www.microchip.com)をご覧ください。

SST 社(Silicon Storage Technology)について

Microchip 社の子会社である SST 社は組み込みフラッシュ技術トップクラスのプロバイダです。SST 社は、特許技術である SuperFlash メモリテクノロジーの各種ソリューションを、コンシューマ、産業、車載、IoT (Internet of Things)市場向けに開発、設計、ライセンス提供、販売しています。SST 社は 1989 年に設立され、1995 年に株式を公開し、2010 年 4 月に Microchip 社に買収されました。SST 社は現在 Microchip 社の完全子会社であり、カリフォルニア州サンノゼに本社があります。詳細は SST 社ウェブサイト(www.sst.com)をご覧ください。

Deca Technologies 社について

Deca 社は先進パッケージング技術のトッププロバイダで、主な技術には M-Series™ファンアウトや、画期的な製造時設計アプローチである Adaptive Patterning®があります。Deca 社の第 1 世代技術は品質と信頼性の新たな基準を確立し、80 億を超えるユニットがスマートフォンで使われています。チップレットとヘテロジニアス集積を目指した第 2 世代の発展により、Deca 社の技術は将来的な主要業界標準としてみなされつつあります。技術パートナーの拡大中エコシステムにより、Deca 社の実証済みの構造、プロ

Deca 社と Silicon Storage Technology 社、NVM チップレット ソリューションの実現に向けた戦略的提携を発表

3-3-3-3

セス、設計システムが実装されており、次世代の製品開発を加速するための様々な選択肢が広がっています。詳細は Deca 社のウェブサイト(www.ThinkDeca.com)をご覧ください。

###

Note: Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴ、Silicon Storage Technology、SST、SuperFlash は米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。その他の商標は各社に帰属します。

詳細については、以下にお問い合わせください。

Helen Tang (Microchip 社):

(メール: Helen.Tang@microchip.com)

松田、仙場 (共同 PR):

(メール: mchp-pr@kyodo-pr.co.jp)

報道関係者の方へ: このニュースリリースのメールによる配信については、共同PR 株式会社 松田もしくは仙場まで電話(03) 6260 4863 またはメール mchp-pr@kyodo-pr.co.jp でお問い合わせください。